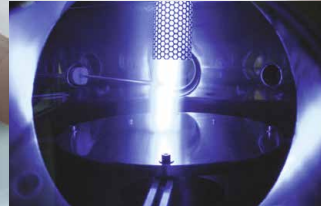
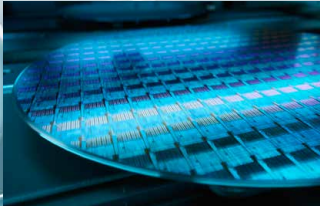




# Isolast® PureFab® JPF50

先端半導体製造プロセス向け  
フッ素系界面活性剤・充填剤不使用のパーフロロエラストマー



**Isolast® (以下: イソラスト) PureFab® JPF50 は、フッ素系界面活性剤と充填剤を一切使用せずに製造された高純度のFFKM材です。環境負荷の低減、長寿命化、歩留まり向上という半導体産業の要求にお応えする材料です。**

当社の次世代型パーフロロエラストマー (FFKM) である イソラスト PureFab® JPF50 は、最高レベルの純度と耐プラズマ性が求められる先端半導体プロセス向けに特別に開発されました。フッ素系界面活性剤を使用しない製造手法により、環境面でのサステナビリティ向上に寄与し、優れた低汚染性能を実現します。

独自の製造プロセスによって耐プラズマ性を向上させており、有機・無機いずれの充填剤も添加することなく高い性能を発揮します。

優れたシール性能に加え、イソラスト PureFab® JPF50は +300 °C(+572°F)までの高温環境下でも極めて低いアウトガス特性を維持し、先端半導体プロセスの厳しい要件に対応します。

## 特長と利点

- フッ素系界面活性剤不使用の製造により環境負荷を低減
- 幅広い化学薬品や主要な成膜用プレカーサに対する極めて優れた耐プラズマ性でシール寿命を最大化
- 超低アウトガス化とパーティクル発生の最小化によりコンタミリスクを低減し、プロセス歩留まりを向上
- 高温環境下でも優れた性能を維持し、過酷なプロセス条件でも信頼性の高いシール性を実現
- 低圧縮永久歪みと優れた機械特性によりメンテナンス周期を延長し、ダウンタイムを削減

## 用途例

- 成膜プロセス (PECVD、HDPCVD、PEALD) およびエッチングプロセス (ALE、ドライエッチング) におけるシールおよび各種コンポーネント
- チャンバーリッドおよびガスインレットシール
- ボンデッド スリットバルブ ドアシール

### ISOLAST® PUREFAB®

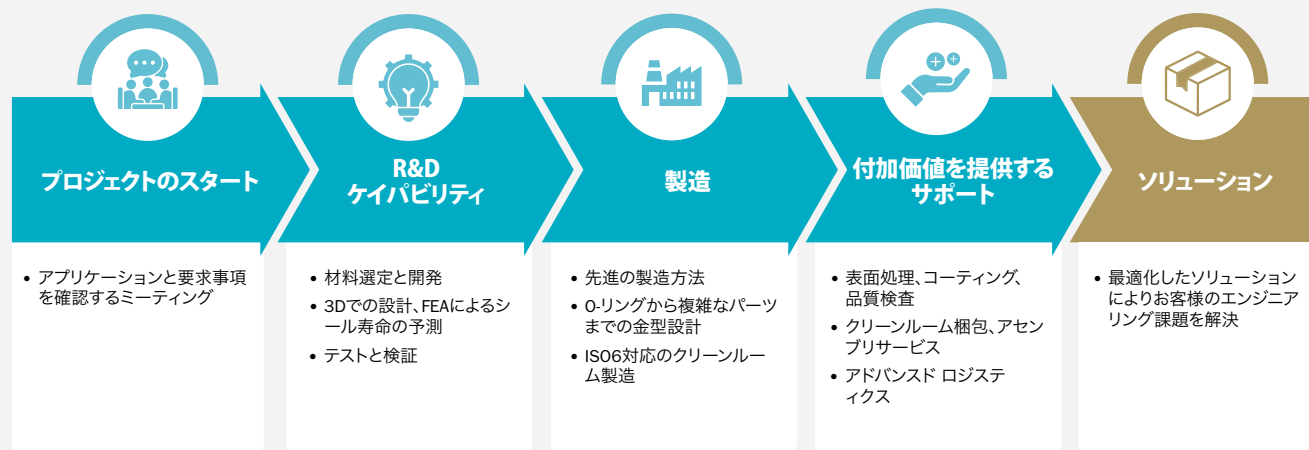
イソラスト PureFab® は、過酷な半導体製造プロセス向け専用に開発されたFFKM材料群です。各グレードは、プロセス化学、システムの設置場所、装置の複雑性を考慮して最適化されており、プラズマ環境や高温条件下において高純度で卓越したシール性能を発揮します。

## ISOLAST® PUREFAB® JPF50

一般データ	イソラスト PureFab® JPF50
エラストマータイプ	FFKM
色	ダークブラウン

物性	テスト方法	結果
硬さ (Shore A)	ASTM D2240	75
引張強度 (MPa)	ASTM D1414	17.3
破断伸び (%)	ASTM D1414	193
100%モジュラス (MPa)	ASTM D1414	4.6
圧縮永久歪み (%)		
72h @ +200 °C/+392 °F	ASTM D395	8
72h @ +300 °C/+572 °F		24
連続使用温度		-5 °C ~ +300 °C/+14 °F ~ +572 °F

## お客様の用途に合わせたポリマーソリューション



トレルボルグでは、お客様との緊密な協業をベースとした地域ごとの専門サポート、グローバルネットワーク、そして半導体分野に精通した専任社員との連携により、設計から試作、量産まで一貫したサービスをご提供します。

詳細情報やお問い合わせ: [www.trelleborg.com/seals/jp](http://www.trelleborg.com/seals/jp)

本資料の情報は一般的な参考用であり、特定用途への適合性を保証するものではありません。製品や材料の適合性については、お客様ごとにご自身で確認する必要があります。色のばらつき(暗点を含む)は、ポリマー硬化工程による通常の現象であり、異物の混入や性能・信頼性・清浄度への悪影響を示すものではありません。

## プラズマプロセスでの使用例をインタラクティブにご覧ください

稼働時間の向上と歩留まり改善を実現する先進的なシールソリューションを、インタラクティブなウェブセクションでご覧ください。

<https://www.trelleborg.com/ja-jp/seals/your-industry/semiconductor/dry-processing-capabilities>

